

飛散や汚染の無い、高精度ワイヤーボンディングを実現

Realizes high precision wire bonding without scattering or contamination

特長

- フラックスフリー&無洗浄ダイボンディングを可能にする、HQ仕様品
- 低ポイドで良好な放熱性が得られる、Niボール入りソルダプリフォーム
- 自動機で高精度搭載を可能にする、テーピング仕様品
- フラックス塗布工程を不要とする、フラックスコート仕様

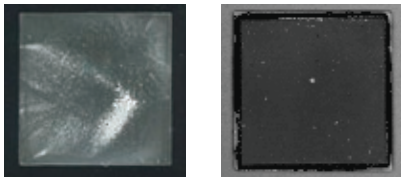
パワー半導体のダイボンディング



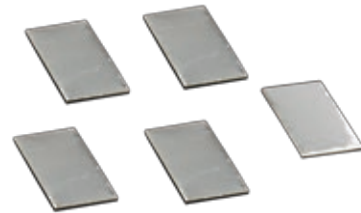
● 用途や目的に応じて、各種仕様品を選べます

特殊表面加工でフラックスが不要なHQ仕様

HQ High-Quality Surface Condition



表面にフラックス塗布を施したフラックスコート仕様



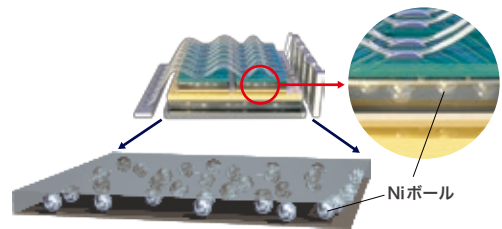
目的別にコーティングフラックスを選択

自動搭載を可能にするトレー or テーピング仕様



異形や大型加工品にも対応

水平実装を実現するNiボール入り仕様

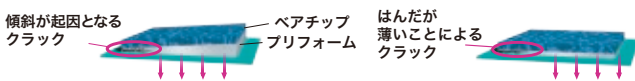


各種ボールサイズを選択が可能

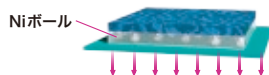
● クラックが入らず、良好な放熱性が得られるNiボール入りソルダプリフォーム

● 高い放熱効果

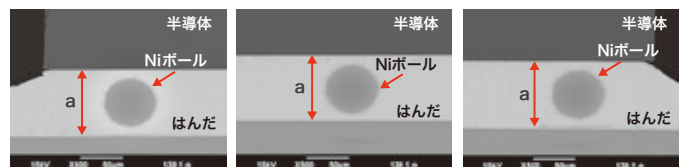
クラックの空気層が、熱伝導性を阻害し放熱効果を低下させる



良好な放熱性



独自のボール封入技術が、良好な反応を示しポイドが少ない



Niボールが部品のスタンドオフとなり、均一なはんだ厚を確保